

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-031

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.	1500 万元	0 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,162
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.34
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“马来西亚槟城金海通”）生产经营和业务发展的资金需求，在确保风险可控的前提下，公司为上述全资子公司提供担保。近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《最高额保证合同》，为马来西亚槟城金海通提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证担保。上述担保事项均不存在反担保的情形。

（二）内部决策程序

公司已于 2026 年 2 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为马来西亚槟城金海通提供额度不超过人民币 1,500 万元（含美元、林吉特或其他等值货币）的担保。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

本次担保属于公司董事会授权范围内，无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（马来西亚槟城金海通）
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有马来西亚槟城金海通 100%股权
法定代表人	CHEE CHOON CHYE
注册号码	202301025284(1519207-T)
成立时间	2023 年 7 月 4 日

注册地	39 IRVING ROAD 10400 GEORGE TOWN PULAU PINANG MALAYSIA		
注册资本	2,303.17 万林吉特		
公司类型	有限公司		
经营范围	从事半导体测试设备的制造、进口、出口、经销、装配、维修、买卖等业务，并提供与半导体行业相关的研究、技术、科学和咨询服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	5,283.20	4,761.40
	负债总额	2,767.72	2,212.84
	资产净额	2,515.48	2,548.56
	营业收入	898.34	97.42
	净利润	-9.17	-904.41

三、担保协议的主要内容

公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

债务人：JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.

保证人：天津金海通半导体设备股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

担保金额：人民币 1,500 万元

反担保情况：无

四、担保的必要性和合理性

本次公司为马来西亚槟城金海通提供担保主要为满足及支持全资子公司生产经营所必要的融资需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司运营管理的

实际需要。被担保方为公司全资子公司，属于公司的重要组成部分，生产经营情况稳定，财务和信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。公司对其日常经营活动决策能够有效控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保涉及金额及合同签署内容在公司第二届董事会第二十四次会议审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 2,162 万元，占公司最近一期（2025 年）经审计净资产的 1.34%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日